

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

554

ML8

Erstellt:

Kracht, Enrico

Kunde:

Datum:

29.09.2015



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
--------------	----------	----	--------	---------------

A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	VS	1		
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	123		2		
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		3		
		35	L2			
A-RS-FR4-ML-0.51mm-035+035-TG150-HF	50200644	510		4	A01	
		35	L3			
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	105		5		
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		6		
		35	L4			
A-RS-FR4-ML-0.51mm-035+035-TG150-HF	50200644	510		7	A02	B00
		35	L5			
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	105		8		
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		9		
		35	L6			
A-RS-FR4-ML-0.51mm-035+035-TG150-HF	50200644	510		10	A03	
		35	L7			
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	123		11		
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		12		
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	RS	13		

Dicke nach Verpressen

B00:

2290 µm

Tol+:

240 µm

Tol-:

240 µm

Dmax:

2530 µm

Dmin:

2050 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

2400 µm

Tol+:

240 µm

Tol-:

240 µm

Dmax:

2640 µm

Dmin:

2160 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

2232 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik